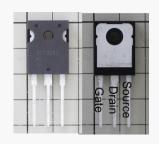


New Release

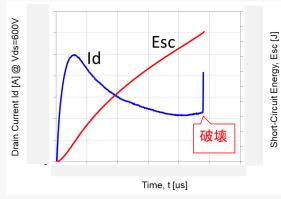
LTEC Corporation

Your most experienced partner in IP protection

ROHM自動車用認定1200V SiC MOSFET (SCT3080HLHR) 短絡耐量評価・解析レポート







<u>概要</u>

パワートランジスタ、特にSiCパワーMOSFETの短絡(SC)耐量は、最も厳しい信頼性関連仕様の1つです。SiベースのIGBTと比較して、SiCトランジスタのサイズが小さいため、SC耐久時間(tsc)が大幅に短縮されています。

レポート概要

今まで、ROHMによって製造された最新**自動車用認定(AEC Q101)** 1200V SiC MOSFETに関する短絡耐量データは報告されておらず、世界最初の短絡データおよびその構造と相関を提供するレポートです。

本レポートの目的、着目点として、

- ・試験測定データの結果と、これらの最先端SiCトランジスタの短絡耐量を制限する物理的メカニズムを特定するための解析評価。破壊までの臨界温度(Tj,crit)および破壊エネルギー(Esc)が抽出されます。
- ゲート酸化膜が劣化し始める臨界温度も考慮されます。
- ・ROHMと他社の1200Vトランジスタの短絡耐量を比較する。短絡耐性を高めるためのトランジスタ構造とプロセスの変化を明らかにする。
- ・電気的特性(オフリーク電流と温度依存性)を比較し、相違点および制限を特定する。

評価結果の重要性と使用法

- ・短絡保護回路の最小応答時間を推測することができる。
- ・測定された短絡ドレイン電流波形と耐久時間(tsc,f)を、SPICE電気・熱シミュレーションで使用し、トランジスタの内部温度を推定することが可能。

レポート販売価格(税別)¥500,000



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8 e-mail: info@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

レポートー部抜粋 (1)

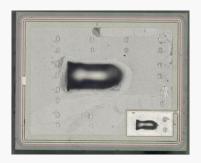
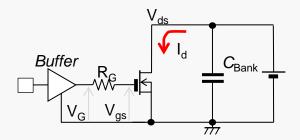
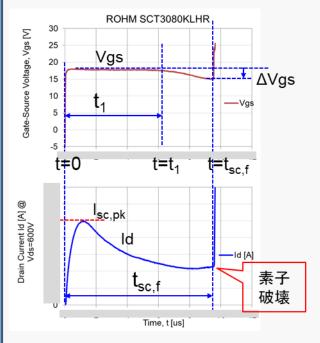


Fig.2: チップ全体像





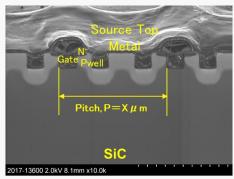


Fig.4: SiCトランジスタセル断面(詳細)

表2: 短絡耐量試験評価条件

| # | Vds [V] | Vgs [V] | 目的 | | |
|---|------------|------------|-------------|--|--|
| 1 | 600 | 18 | 基本短絡特性確認 | | |
| 2 | 600 | 18 | 再現性確認 | | |
| 3 | 400 | 18 | ドレイン電圧依存性確認 | | |
| 4 | 800 | 18 | u | | |
| 5 | 600 | 15 | ゲート電圧依存性確認 | | |
| 6 | 600 | 20 | ű | | |
| 7 | 600 | 24 | u | | |



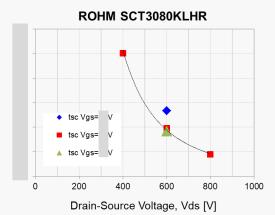
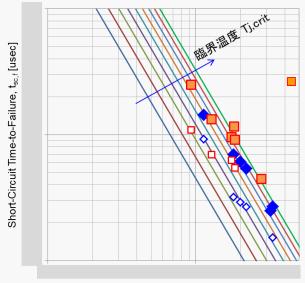


Fig.18:測定された短絡破壊時間(耐久時間)tsc,f 対ドレイン電圧依存性



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8 e-mail: info@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

レポートー部抜粋 (2)



Dissipated Power Density, P_d/A [W/mm²]

Fig.28:測定された短絡時間(t_{sc,f})と消費(放熱) 電力密度の比較Pd/A=(Vds x Id)/A.

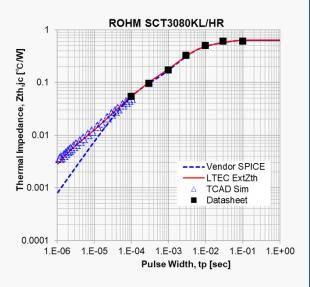
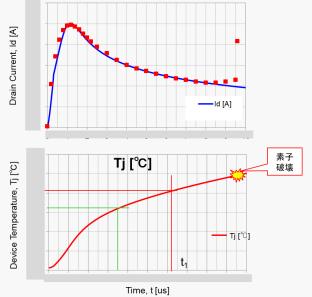


Fig.29: SCT3080KLHR熱インピーダンスプロットデータシートで記載されたデータ(■)、トランジスタの構造パラメータ(△)、およびLTEC合成のSPICEモデル(青い線)を使用して計算された熱インピーダンスを示す。



OFF-State Drain Current Density, Idss/AA

Si IGBT

SiC MOSFETs

O 200 400 600 800 1000 1200

Drain Voltage, Vds [V]

Fig.33: 測定されたオフ状態のドレインリーク電流(@ Vgs = 0V)

Fig.30: 短絡過渡SPICEモデリングおよび抽出されたトランジスタの温度上昇。



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目<u>42-8</u> e-mail: info@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

Table of Contents

| 【目 | 次】 | | 頁 |
|----|-----|--|----------|
| 1 | 1.1 | 背景、レポート目的とエグゼクティブサマリー ・・・・・・・・・・ | 3 |
| | | はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 2 | | ROHM社SiC MOSFET「SCT3080KLHR」デバイス構造 ····・ | 5 |
| | 2.1 | デバイス構造/材料解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| | | 表1. 構造パラメータの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 3. | | 短絡試験 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7 |
| | | 短絡試験回路 ····· | 8 |
| | | 短絡耐量試験評価条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| 4 | | 短絡耐量試験測定結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| | 4.1 | 短絡耐量試験:電圧および電流波形結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-16 |
| | | 表 3: ROHM SCT3080KLHR SiC MOSFETの短絡耐量特性 | |
| | 4.2 | 測定結果の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 測定結果の解析と考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 19 |
| | ٦.٢ | 短絡時ピークドレイン電流I _{sc,pk} 対ドレイン電圧Vdsと ゲート電圧Vgsの依存性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| | | 短絡破壊時間(耐久時間)t _{sc.f} 対ドレイン電圧依存性・・・・・ | 21 |
| | | ドレイン電圧Vdsに対する短絡エネルギーE _{sc,f} ・・・・・・・・・・ | 22 |
| | | 消散電力Pd =(Vds×Id)に対する短絡故障時間(t _{sc,f})・・・ | 23 |
| | 4.3 | ゲートリーク電流に関する考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24-26 |
| | 4.4 | 温度上昇 Δ Tjの解析と推定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27-29 |
| | | 熱インピーダンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| 5 | | ROHMのSiCトランジスタの構造と電気特性比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33-38 |
| | | ROHM と Wolfspeedトランジスタ電気特性比較 ・・・・・・・・・・ | 35 |
| | | ROHM と Wolfspeedトランジスタ短絡ドレイン電流波形の比較 | 37 |
| 6 | | まとめ | 39 |
| 7 | | 参考文献 ····· | 40 |

